

米国「OCP Global Summit 2026」に次世代 AI インフラを支える当社水冷配管製品を展示 ～村田製作所の電源ソリューション、日東工業の OCP ORV3 ラックとともに展示～

三桜工業株式会社（登記社名：三桜工業株式会社、以下「当社」）は、2026 年 10 月 12 日（月）から 10 月 15 日（木）まで米国カリフォルニア州サンノゼで開催される「OCP Global Summit 2026」株式会社村田製作所（本社：京都府長岡京市、代表取締役社長 中島 規巨、以下「村田製作所」）ブースにて、水冷配管製品を展示します。

生成 AI の急速な普及に伴い、データセンタのインフラにはより高い性能と効率性が求められています。「OCP Global Summit」は、次世代 AI データセンターの課題解決に向けた最新技術が集結する世界で最も重要なイベントの一つです。

本サミットでは、Open Compute Project（OCP）* の最新仕様「OCP ORV3（Open Rack V3）」に準拠し、AI ワークロードに代表される高密度・高発熱な IT 機器の実装に最適化された日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 手嶋 晶隆、以下「日東工業」）の次世代データセンター向けラックに当社のマニホールド及び水冷配管アセンブリを実装・展示します。

データセンター向け電源ソリューションのグローバルリーダーである村田製作所ブースでの展示により、3 社の技術を結集した、高効率で信頼性の高い統合ソリューションをご提案します。

「OCP Global Summit 2026」にご来場の際は、ぜひ村田製作所ブースにお立ち寄りいただき、当社の水冷配管製品をご覧ください。

■ 概要

イベント名	OCP Global Summit 2026
開催日程	2026 年 10 月 12 日（月）～10 月 15 日（木）
会場	San Jose McEnery Convention Center （米国 カリフォルニア州 サンノゼ）
出展ブース	株式会社村田製作所ブース内（A15）
公式サイト（英語）	https://www.opencompute.org/summit/global-summit

*OCP(Open Compute Project):

Meta 社(旧 Facebook)が中心となって設立した非営利団体です。データセンターのハードウェア設計をオープンソース化することでイノベーションを促進し、効率的なデータセンターの構築を目的としたプロジェクトです。

■ 出展製品



ラックマニホールド(赤枠内)



水冷配管アセンブリ